



台灣晶技股份有限公司 法人說明會

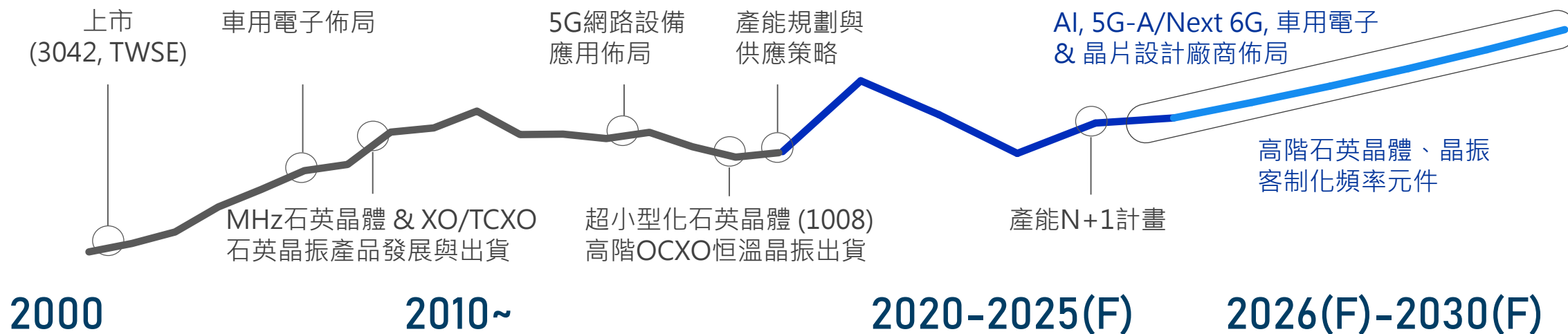
免責聲明

- 除涉及歷史事項之陳述外，本簡報所載之陳述均屬前瞻性陳述。該等前瞻性陳述涉及已知與未知之風險、不確定性及其他因素，可能導致本公司實際經營表現、財務狀況或營運結果與前瞻性陳述所隱含之內容產生重大差異。
- 本簡報所載之財務預測及前瞻性陳述，係反映本公司於本簡報日之現時判斷。對於該日之後所發生之事件或情況，本公司不負更新該等預測及前瞻性陳述之義務。
- 涉及歷史事項之陳述可能包含未經會計師查核之資訊，該等資訊或有不足或缺漏，未必允當表達本公司之財務狀況或營運結果。

台灣晶技(3042) 跨越每個世代，成就更美好的連結



台晶(TXC, 1983年成立)經營實績2000-2024 & 2025-2030(F) (營收表現穩健，保持5G、車用電子市場領先優勢)



邁向智慧分散式通訊生態系的整合架構

運算分散化、通訊融合化、同步精準化

通訊路徑

同步路徑

COMPUTE

Workloads distribute across cloud, edge and devices.

CLOUD TRAINING

Large-scale models and data processing

HYBRID INFERENCE

Edge AI and low-latency decision-making

ON-DEVICE CONTROL

Real-time control and actuation

CPU

GPU

NPU

ASIC

COMMUNICATION

High-bandwidth, low-latency, always-on connectivity.

UALink / PCIe

High-speed die-to-die and system links

UEC / Ethernet / Optics

Deterministic transport at scale

Wi-Fi 8 / 5G-A / 6G

Wireless connectivity for mobile and IoT

TSN / DetNet

Deterministic networking and service assurance

SYNCHRONIZATION

Precise, resilient timing across every domain.

LOCAL REFERENCE CLOCKS

Accurate, stable time sources

PTP / SyncE NETWORK TIME

Network-wide time distribution

MULTI-DOMAIN gPTP

Coordinated time across domains

HOLDOVER + DETERMINISTIC CONTROL

Resilient timing for mission-critical control

EVIDENCE



<1
microsecond
PTP target range



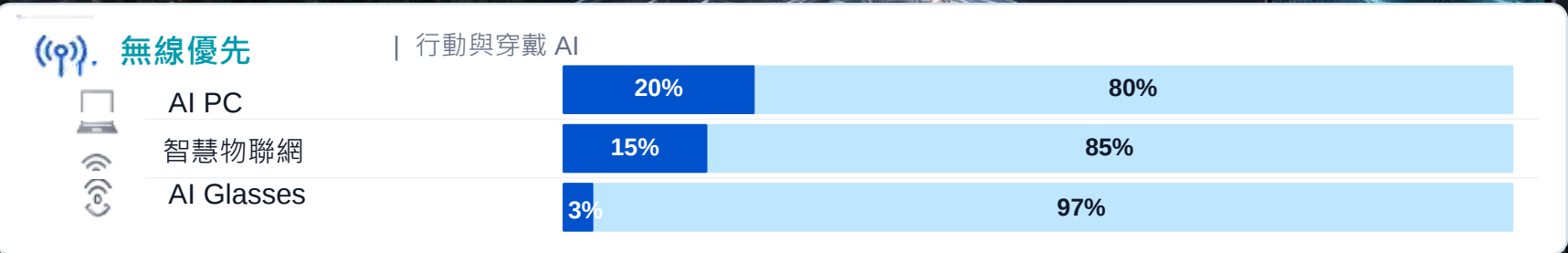
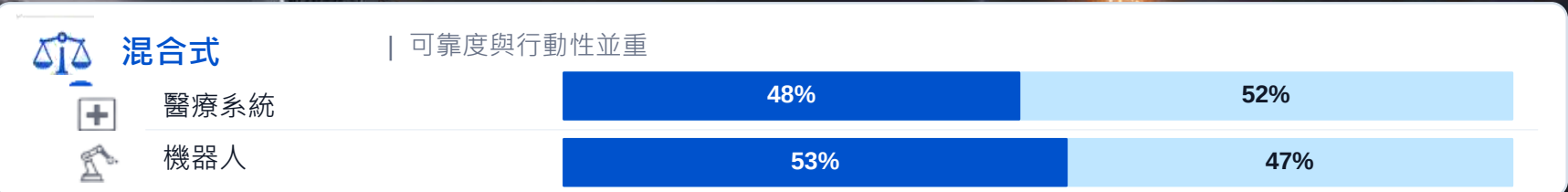
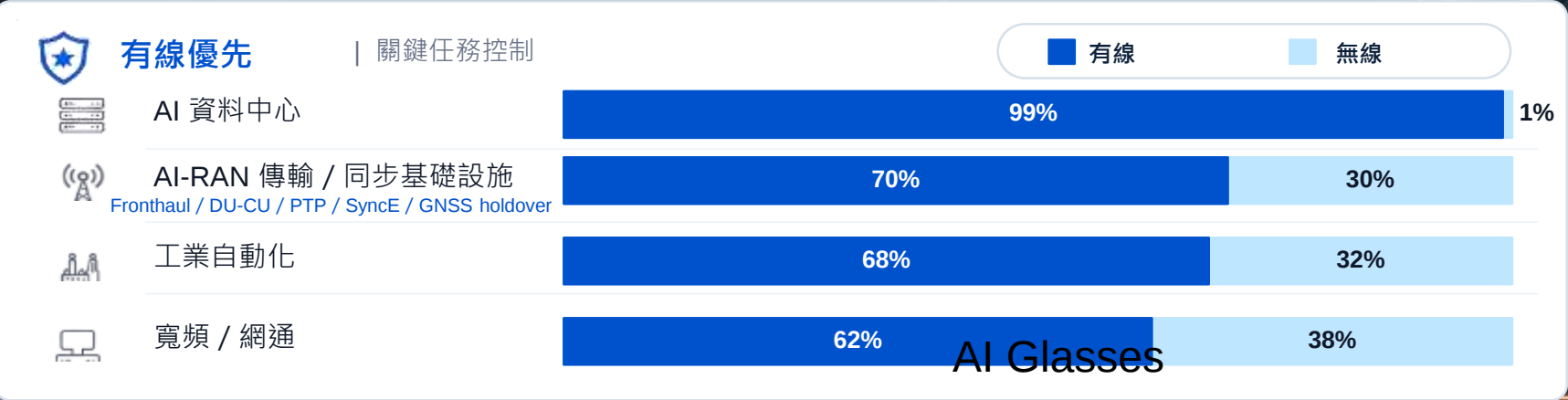
128
5G-supported
gPTP time domains



≤900 ns
5G-TSN time-error
reference

精準時脈，驅動 AI 分散式生態系協同運作

走向邊緣 AI應用導向的最佳化/差異化設計



時脈價值如何改變



有線優先系統

更高頻率、更低jitter與相位雜訊以及長期高精度穩定性



混合式系統

強固化、寬溫 (125°C) 且高可靠度的時脈



無線優先系統

超微型化、低功耗 且熱穩定性佳的時脈

從頻寬成長到時脈價值的擴張

AI 基礎建設的效能，正轉向資料搬移、同步與時脈域複雜度

— Scale-up 垂直擴展

GPU 對 GPU (NVLink / UALink)

— Scale-out 水平擴展

機櫃對機櫃 (AOC / AEC)

— 儲存 (記憶體池化)

CPU + DPU + 網路

— 高速互連

光通訊 / SerDes / PCIe / CXL

架構正在改變什麼

- 光通訊邁向 1.6T 與 3.2T

PAM4 已延伸至 448G ; PAM6 與 PAM8 正於電性通道評估中

- 多種協定並存於同一系統

NVLink、UALink、CXL、PCIe Gen 6/7 與乙太網路並行運作

- 時脈域數量倍增

GPU、CPU、DPU、NIC、交換器與光模組各自帶有獨立時脈

時脈發展演變方向

- 更高的參考頻率

隨著飽率提升，參考時脈的頻率隨之上移

- sub-30 fs 成為進入門檻

相位抖動已從差異化條件，轉為基本要求

- 跨更多時脈域的同步

在時脈域持續增加的情況下，穩定度必須維持

時脈價值提升重估

- 差分 XO / 精準 TCXO

高速通訊關鍵時脈元件



ASP : +50%

每機櫃時脈價值 (ASP) 提升



**精準同步
新增振盪器需求**

因應IEEE 1588 新增時脈用量

相同應用位置。更高的規格。創造更高價值層級

6G RAN：從基地台規模走向時脈價值提升

隨著 6G 延伸至更多網路域，時脈價值同步成長

雲端化、架構解構與非地面網路(NTN)發展演進，擴大時脈域與同步挑戰升

無線接取
射頻同調

傳輸網路
PTP / SyncE

運算
邊緣 AI-RAN

衛星
GNSS / NTN

架構在改變什麼

● 網路架構解構

RAN 拆分為 DU 與 CU 並運行於通用運算平台，各自帶有獨立時脈

● 參考頻率上移

自 10 MHz 提升至 100 MHz 與 491.52 MHz，以支援 FR3 與 THz 感測所需的射頻同調

● 時脈延伸至太空

GNSS 與 NTN 將非地面鏈路納入地面同步鏈

時脈發展演變方向

● sub-5 ppb 等級穩定度

精度必須在解構式與非地面時脈域中維持一致

● 無 GNSS 時的 holdover 能力

衛星訊號中斷時，需維持 4 至 12 小時、1.5 μ s TAE 的時間誤差

● 可網管、可遠端校調

支援遠端校調與軟體控制，因應邊緣 AI-RAN 自動化需求

時脈價值提升重估

● OCXO / 精準 TCXO

同步等級提升後的關鍵時脈元件



6G通感一體(ISAC)

先進 OCXO 等級帶動 ASP 提升



邊緣AI RAN 運算

單一站點整合運算時脈域數量

相同站點規模。更多時脈域。更高時脈規格升級

提升每一台車的時脈價值

車用市場的成長關鍵，在於提升整體價值，而非僅追求出貨數量

— ADAS 先進駕駛輔助

感測融合 / 域控制

— 智慧座艙

AI 座艙 / 車載資訊娛樂

— 區域網路架構

乙太網路 / 光通訊 / TSN / 閘道器

— 車聯網 / GNSS

V2X / 定位 / 連網

25 Gb/s

車用乙太網路 / TSN

32 Gbps

MIPI A-PHY 感測器 I/O

40+

攝影機 / 雷達 / 光達感測節點

E/E 電子電氣架構

分散式 ECU

域控制

區域控制

中央運算

時脈域複雜度

中央運算單元

區域控制器

攝影機 / 雷達 / 光達

乙太網路 / 光通訊 / TSN

GNSS / V2X

座艙 / 常時運作

時脈發展演變方向

● 車規 Grade 1 涵蓋範圍擴大

時脈元件走出座艙，工作溫度需達
-40°C 至 +125°C

● 4D 雷達需要更高頻率

感測解析度的提升，推動參考頻率上移

● 低 EMI 與多無線共存

GNSS 與 Wi-Fi 7 須在同一車輛內共存而不
互相干擾

時脈價值提升重估

● 石英晶體與晶振

全面產品系列，皆通過車規驗證

20~25%
滲透率

AI 世代驅動汽車電子生態系全面升級

L2 進入 L3 +45 顆

汽車正在成為Edge AI核心應用平台

ECU持續整合，時脈需求與價值同步提升

邊緣AI多元應用將形成各階段成長浪潮

依據不同發展時程，帶動長期成長機會

2026-27 SCALE NOW

AI PC, smart camera,
edge gateway

HIGH CONFIDENCE

2027-28 EXPAND

AI glasses, industrial vision,
on-prem agent appliance

MEDIUM-HIGH

2028-30 QUALIFY

Medical AI, private 5G/TSN,
robot fleets

MEDIUM

2030+ OPTION VALUE

Humanoid and generative
Physical AI at scale

LOW / VOLATILE



致力發展時脈技術創新，支持新世代科技發展



石英晶體 (Crystal & TSX)



石英晶振 (CMOS / TCXO)

超高頻

超微型化

更高 Q 值

更高工作溫度

強固化可靠度

更佳耐熱特性

更高驅動功率

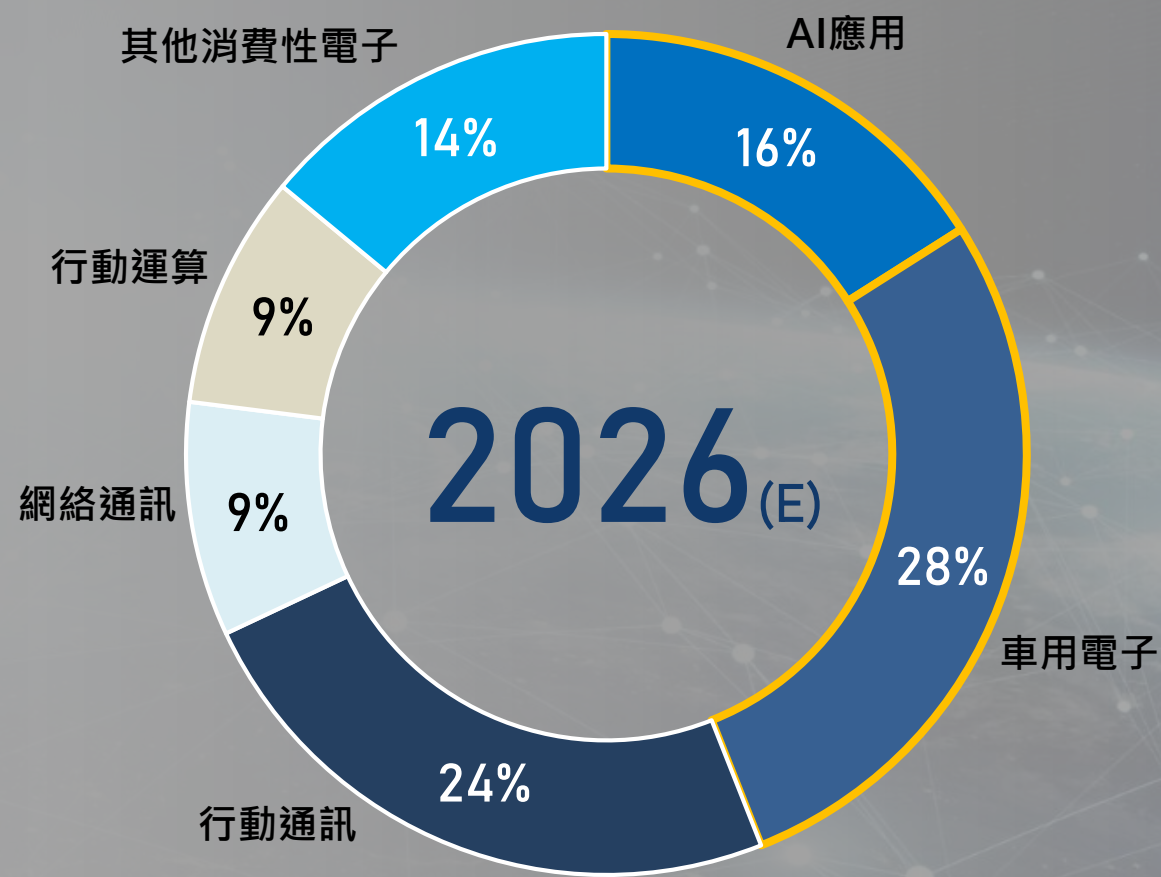
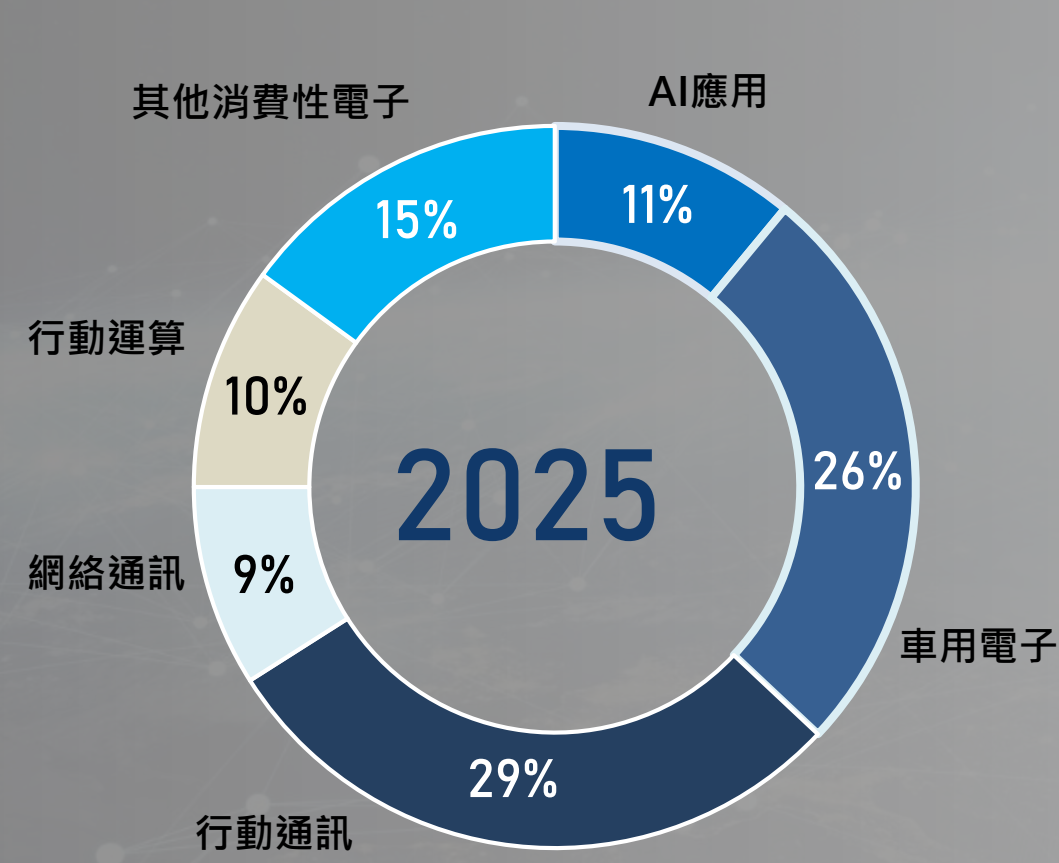
更低 ESR

超低相位雜訊與抖動

低功耗

重點產業營收占比

關注重點產業區塊，挹注營收成長動能



綜合損益表

穩健成長，健康財務結構

單位: 台幣百萬	Q2'26	Q1'26	QoQ	YOY	H1'26	H1'25	YoY
營業收入	3,699	3,339	10.77%	9.87%	7,038	6,533	7.73%
營業毛利	1,225	1,080	13.42%	8.23%	2,304	2,252	2.32%
營業費用	602	576	4.56%	3.54%	1,178	1,187	-0.71%
營業淨利	622	503	23.55%	13.20%	1,126	1,065	5.70%
營業外收入及支出	48	50	-3.86%	133.39%	97	-81	219.64%
稅前淨利	670	553	21.09%	64.75%	1,223	984	24.36%
稅後淨利	555	450	23.31%	49.96%	1,006	842	19.43%
基本每股盈餘(新台幣元)	1.64	1.32	24.24%	51.85%	2.96	2.46	20.33%
營業毛利率(%)	33.11%	32.33%			32.74%	34.47%	
營業費用率(%)	16.28%	17.25%			16.74%	18.17%	
營業淨利率(%)	16.82%	15.08%			16.00%	16.30%	
稅前淨利率(%)	18.11%	16.57%			17.38%	15.06%	
純益率(%)	15.01%	13.49%			14.29%	12.89%	

資產負債表

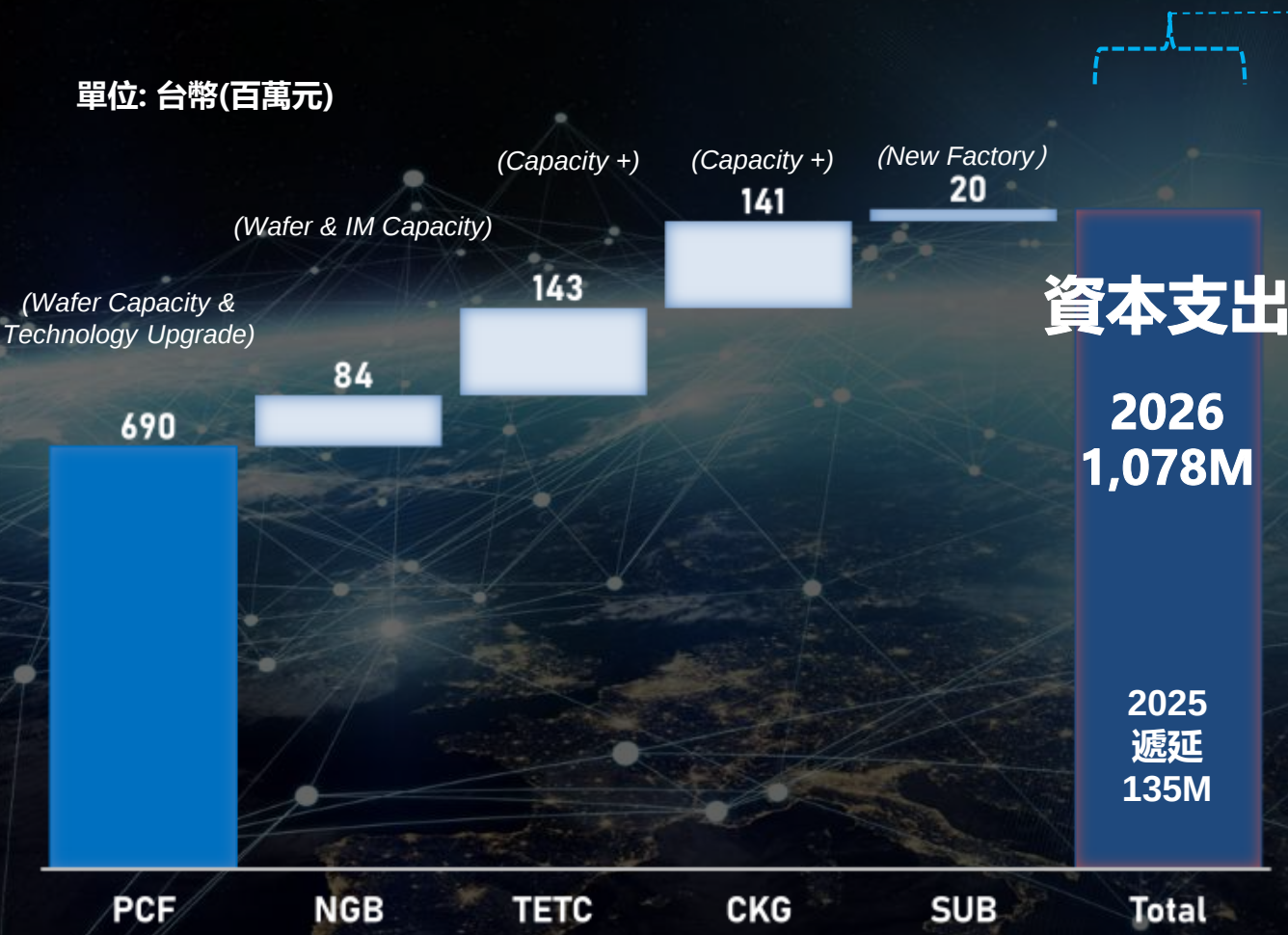
穩健成長，健康財務結構

單位: 台幣百萬	Jun. '26		Dec. '25		Jun. '25	
Item	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及約當現金	4,682	20.1%	3,877	17.8%	5,943	25.7%
應收票據及應收帳款	3,744	16.1%	3,666	16.8%	3,332	14.4%
存貨	3,163	13.6%	2,732	12.5%	2,789	12.0%
流動資產	14,532	62.4%	12,949	59.3%	14,063	60.8%
總資產	23,293	100.0%	21,820	100.0%	23,147	100.0%
流動負債	6,095	26.2%	4,069	18.6%	6,689	28.9%
非流動負債	1,324	5.7%	1,713	7.9%	1,789	7.7%
總負債	7,419	31.9%	5,783	26.5%	8,478	36.6%
合併股東權益	15,874	68.1%	16,037	73.5%	14,669	63.4%
平均收現日數	96		102		99	
平均銷貨日數	114		113		120	
流動比率(%)	238%		318%		210%	
負債比率(%)	31.9%		26.5%		36.6%	
總資產報酬率(%)	9.2%		8.5%		7.6%	
股東權益報酬率(%)	12.7%		11.1%		10.8%	

2026 資本支出計畫

AiX 數位轉型, 全球化生產佈局, 永續經營

單位: 台幣(百萬元)



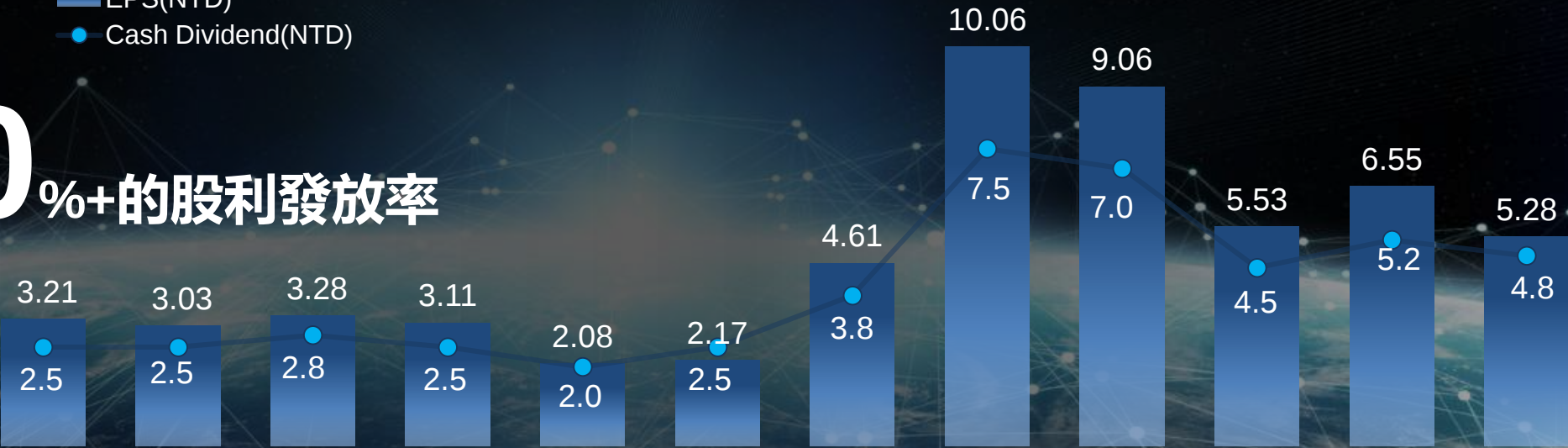
資本支出重點區塊說明	
◆ A+ Enhancements ✓ Core Technology ✓ Advanced Process ✓ Innovation Capability	◆ Smart Factory ✓ Smart Manufacturing ✓ Automation and Robotics ✓ Data Analytics and AI
◆ ESG Sustainability ✓ Environment ✓ Social Responsibility ✓ Governance	◆ N+1 New Factory ✓ Indonesia ✓ Asia

每股盈餘與現金股利

穩定殖利率與高配息

■ EPS(NTD)
● Cash Dividend(NTD)

平均80%+的股利發放率



Year	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Share Price	41.1	44.5	39.0	36.0	44.0	99.8	98.0	89.4	105.5	100.5	91.0
Payout Ratio(%)	82.5%	85.4%	80.4%	96.2%	115.2%	82.4%	74.6%	77.3%	81.4%	79.4%	90.9%
EPS (NTD)	3.03	3.28	3.11	2.08	2.17	4.61	10.06	9.06	5.53	6.55	5.28
Cash Dividend(NTD)	2.5	2.8	2.5	2.0	2.5	3.8	7.5	7.0	4.5	5.2	4.8

敬請指教

Think of Frequency, Think of TXC

著作權與商標聲明 版權所有

本文件所載台灣晶技之全部內容（文字、商標、插圖、照片、圖形、檔案、設計、編排等）均受著作權法及其他相關法令保護。